



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D202463 S

(45)公告日：中華民國 109 (2020) 年 02 月 01 日

(21)申請案號：108302587

(22)申請日：中華民國 108 (2019) 年 05 月 07 日

(51)LOC.(11)Cl.：13-99

(30)優先權：2018/11/19 日本

2018-025160

(71)申請人：日商國際電氣股份有限公司 (日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)
日本

(72)設計人：三部誠 SAMBU, MAKOTO (JP)；津里誠 TSURI, MAKOTO (JP)；藤井悟史 FUJII, SATOSHI (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW 559904

TW I348725

TW 200509191

TW 201543604

JP D1343920

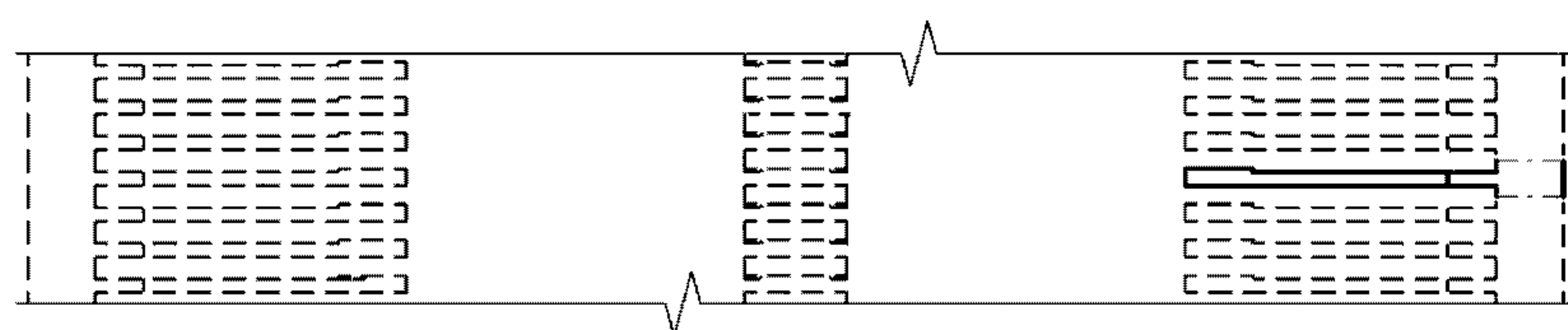
審查人員：徐銘峯

圖式數：12 共 9 頁

(54)名稱

基板處理裝置用晶舟之部分

代表圖：



【C-C放大圖】



D202463

【設計說明書】

【中文設計名稱】 基板處理裝置用晶舟之部分

【物品用途】

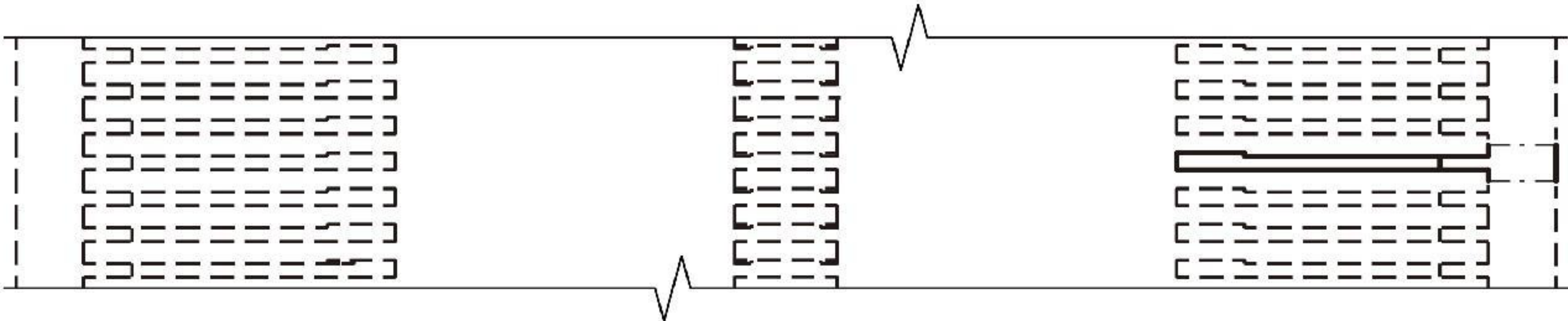
【0001】本設計的物品是基板處理裝置用晶舟，為一種在半導體晶圓上進行成膜時，在反應室內將半導體晶圓保持水平的晶舟。

【設計說明】

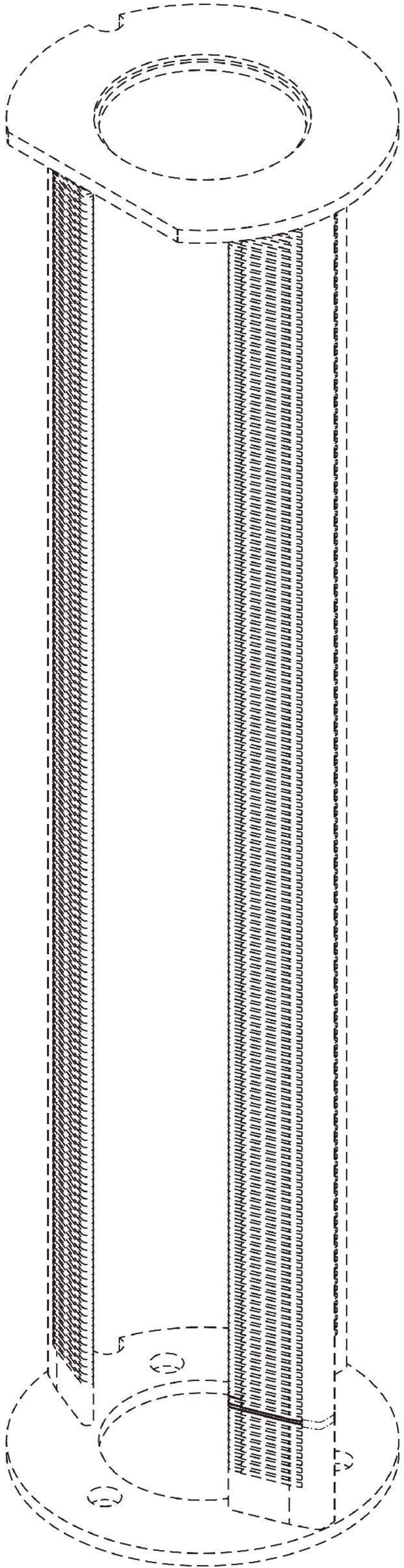
【0002】圖式中所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分；圖式中一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。

【0003】如「主張設計部分之放大立體圖」所示，在中央部形成有凹下部的梳子狀的保持部係用以載置半導體晶圓。

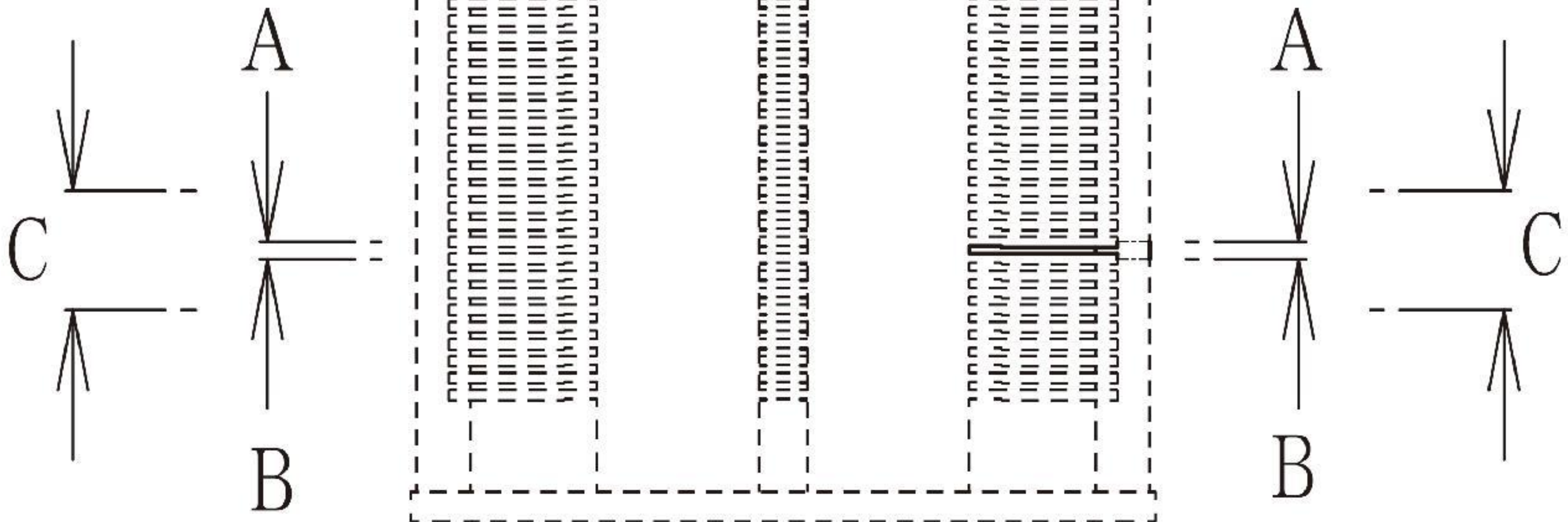
【設計圖式】
(指定代表圖)



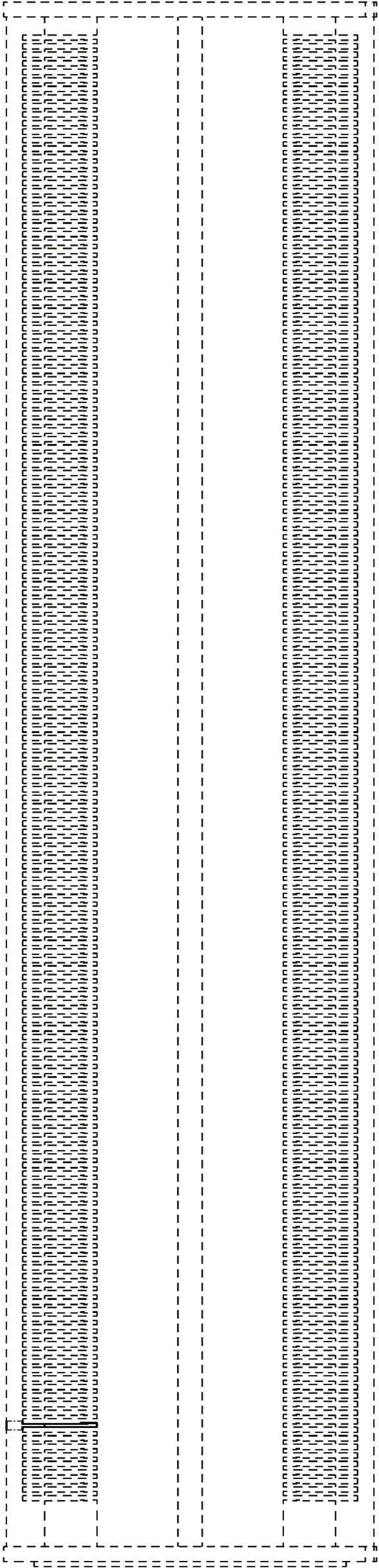
【C-C放 大 圖】



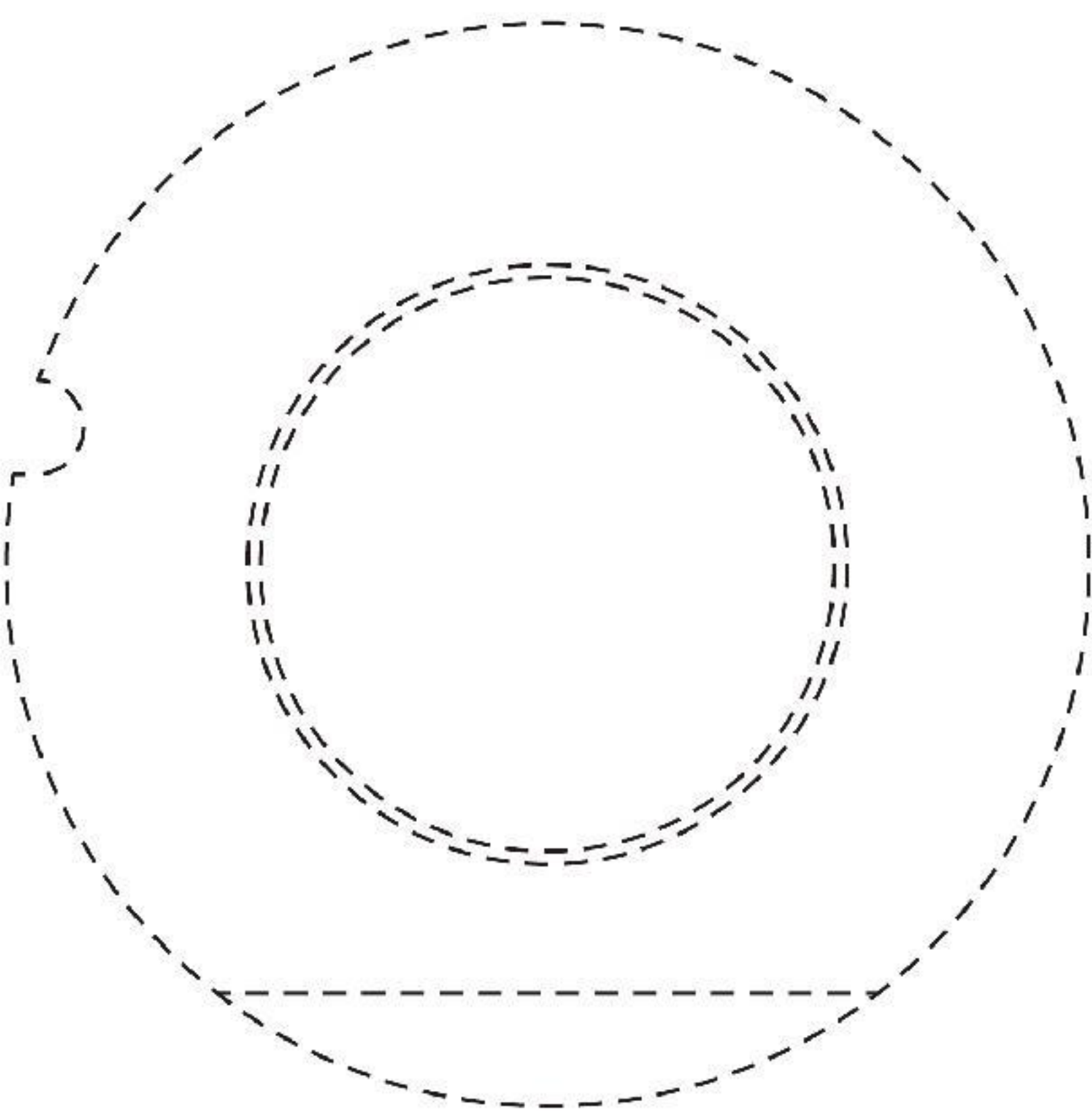
【立體圖】



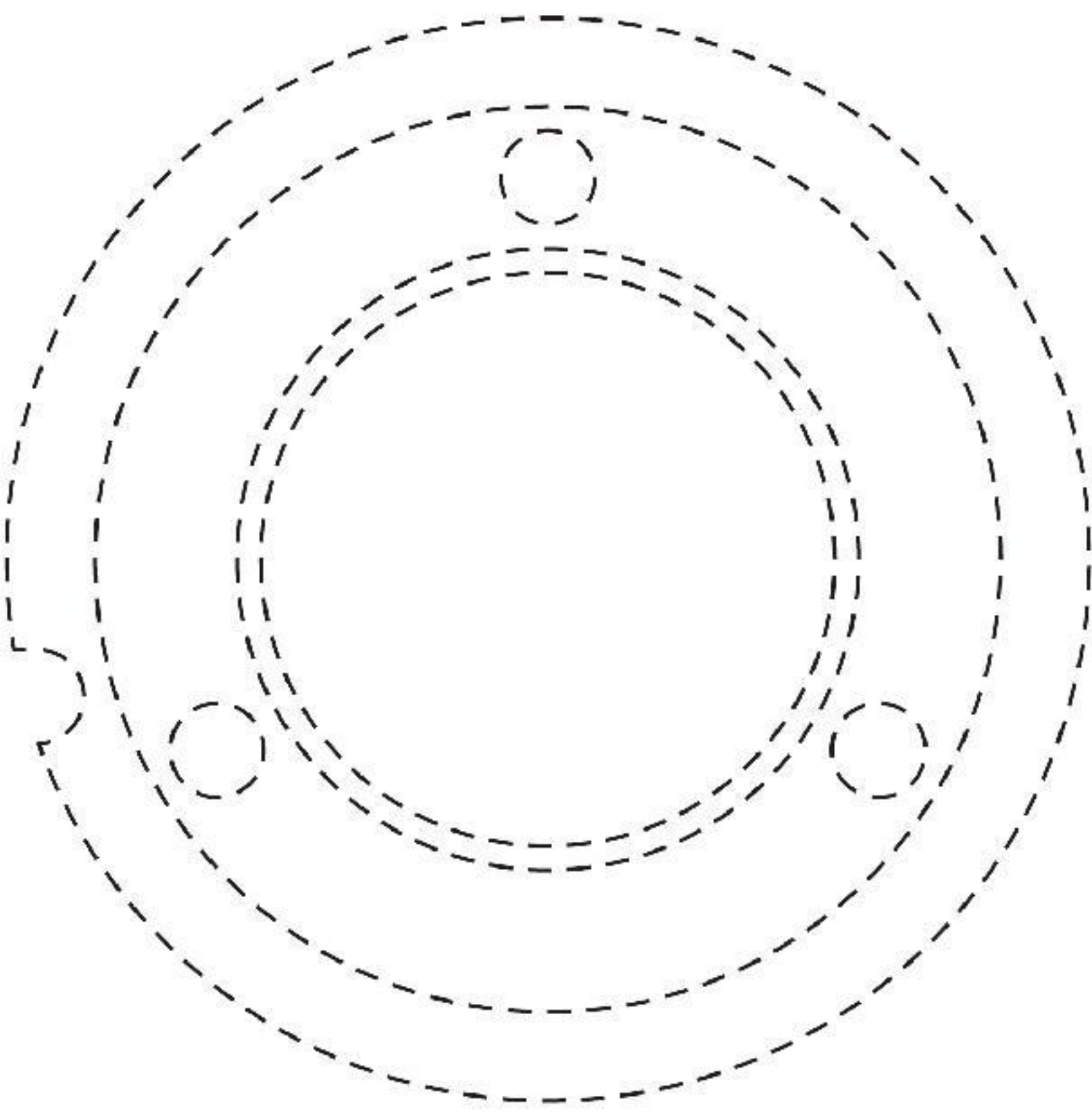
【前視圖】



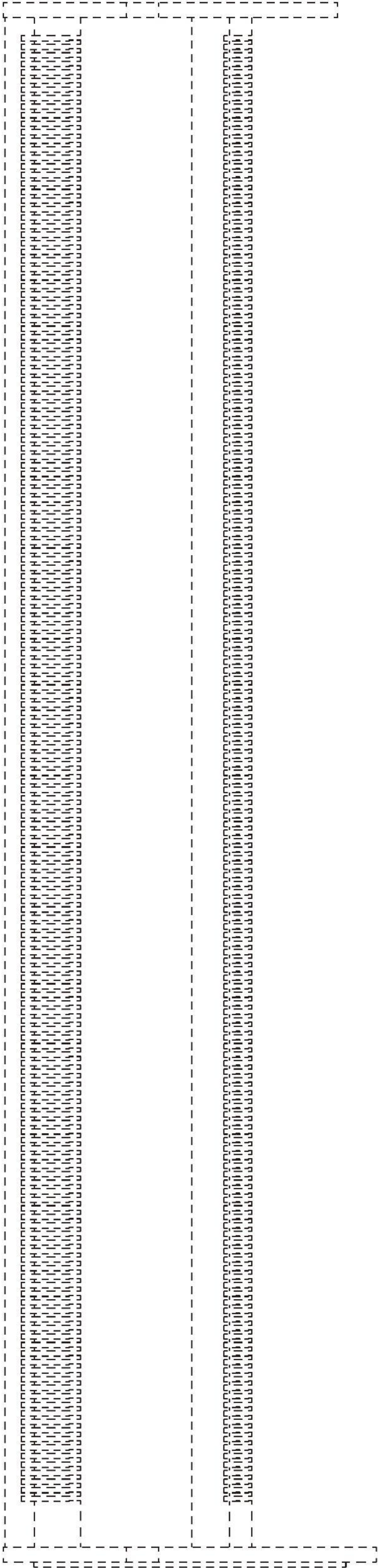
【後視圖】



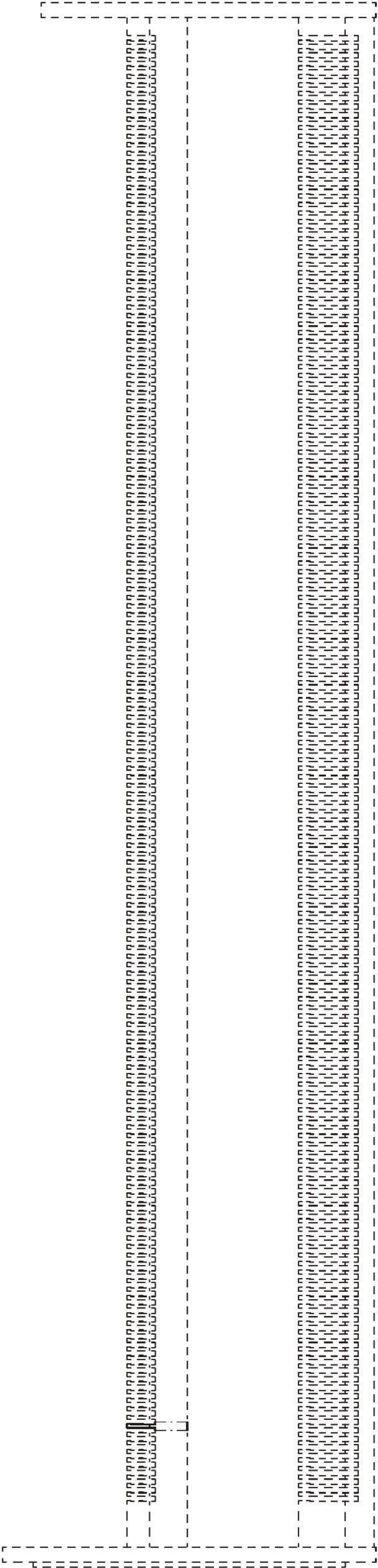
【俯視圖】



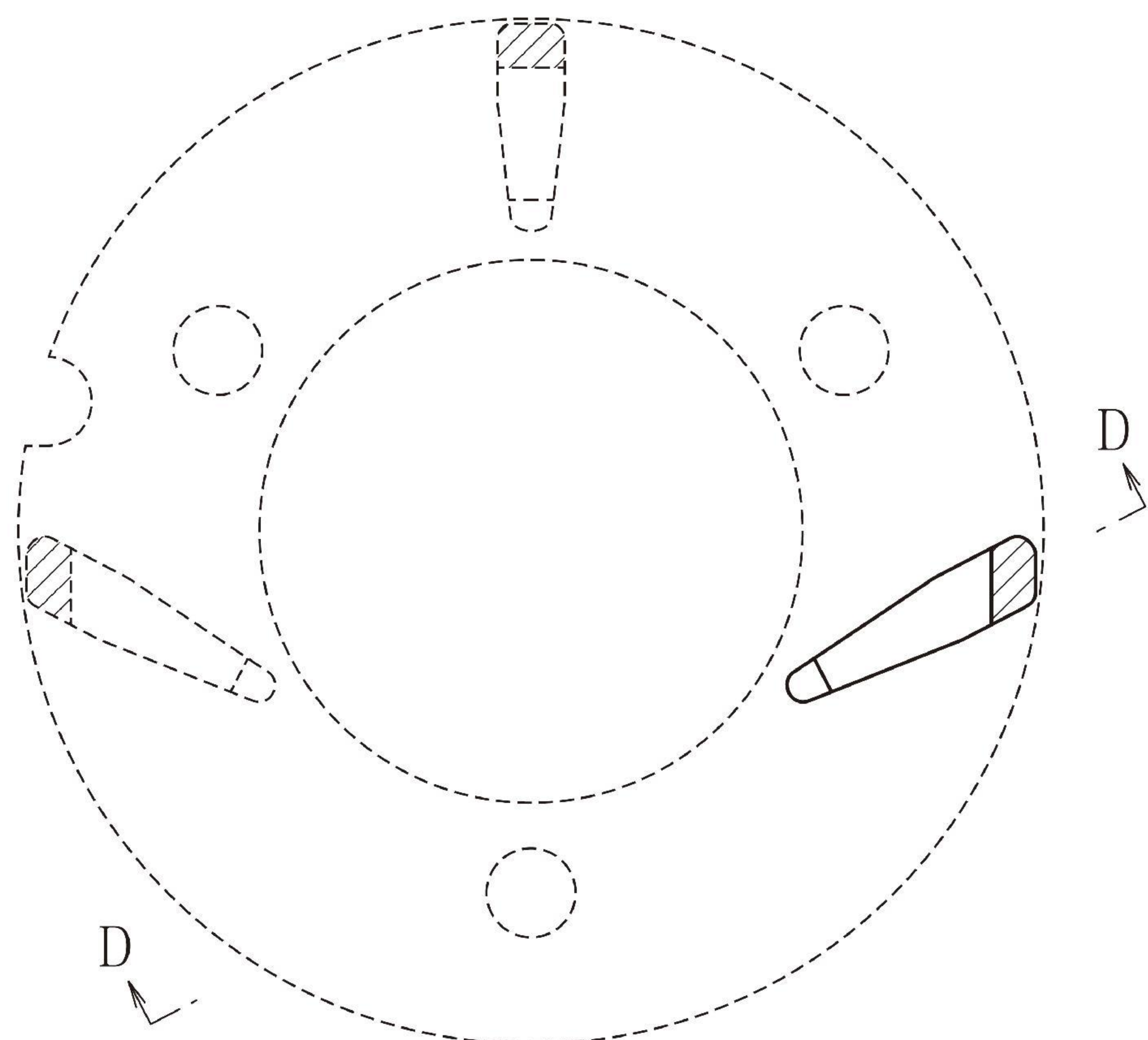
【仰視圖】



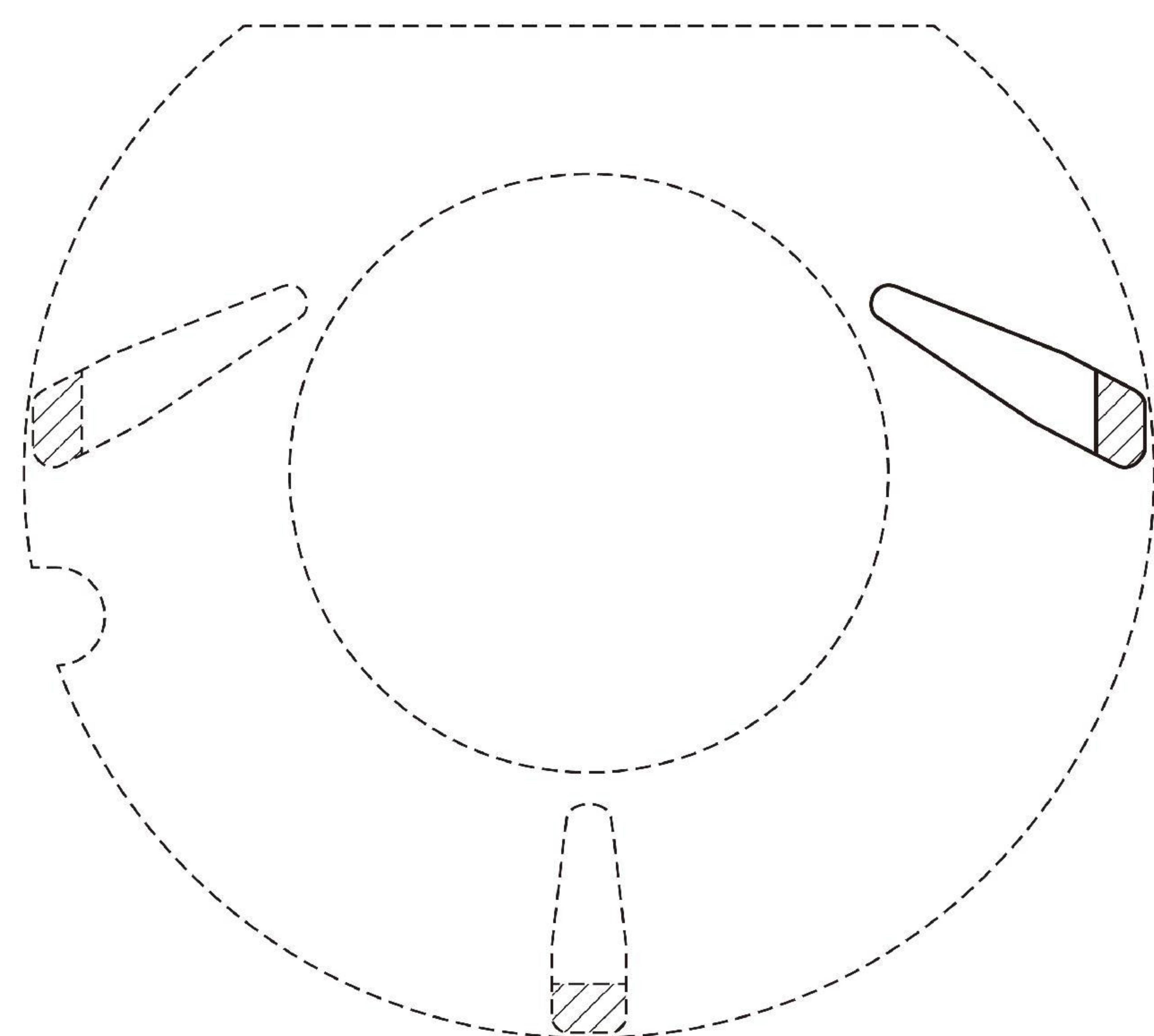
【左側視圖】



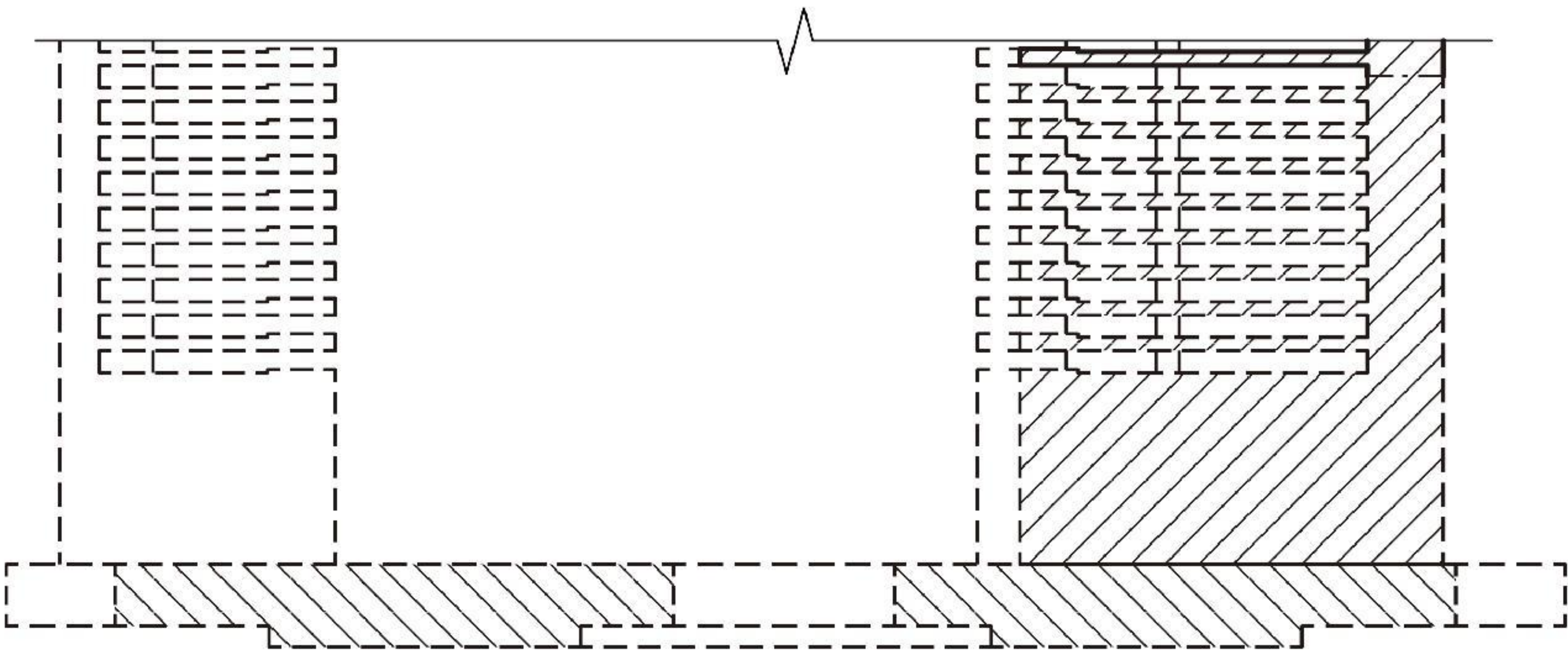
【右側視圖】



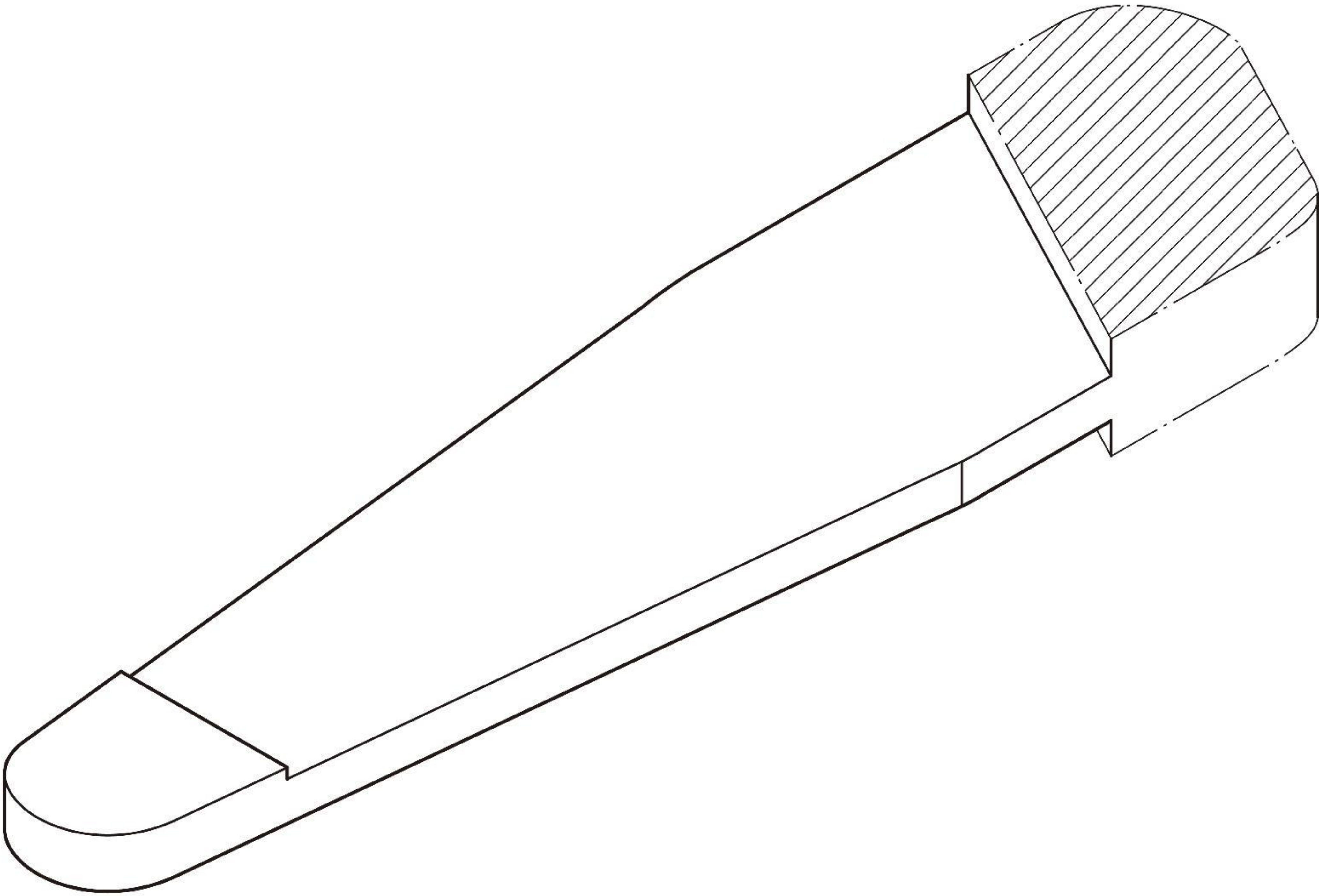
【A-A放大剖面圖】



【B-B放大剖面圖】



【D-D剖面圖】



【主張設計部分之放大立體圖】